

ノンシリコーンギャップフィラー

東京インキ株式会社

熱伝導性、難燃性、電気絶縁性を有するノンシリコーンギャップフィラーです。発熱体とヒートシンク等の冷却器との隙間に充填する事で、優れた放熱効果を発揮します。充填時は液状で自動実装が可能で、実装後は硬化して液痩せ/タレが発生しない為、信頼性を必要とされる場所にお使いいただけます。また、シリコーンを使用していない為、低分子シロキサンに起因する電気接点障害が気になる場所にお使いいただけます。



ペースト状で被着体形状へ追従



良好なリワーク性



製品例

2 液硬化型ギャップフィラー

特徴

■ カスタム設計

熱伝導率／粘度／硬さ
硬化時間／色相 ほか

■ 低比重設計

■ 耐摩耗設計

■ 湿度依存性のない常温硬化反応

■ 長期保存安定性

仕様一例

項目		2W/m・K品	3W/m・K品	5W/m・K品
混合比	—	1 : 1	1 : 1	1 : 1
ポットライフ RT	min	30～60	30～60	30～60
完全硬化時間 RT	days	2～3	1～2	1～2
比重	—	1.9	2.1～2.8	3.2
硬さ	shore 00	70～90	70～90	70～90
難燃性	UL94	V-0	V-0 / V-1	V-1

※上記記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。

お問合せ先

株式会社中外 新規事業開発部

TEL : 050-7776-0504

E-mail: business-development-shared@chugai-jp.com

